

## *Реферат*

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу осадження міді на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу.

Дорош К.Г. – Київ: НТУУ «КПІ», ХТФ, ХЕ-11

Дипломний проект, 2015 рік. Кількість сторінок - 125, таблиць – 32, рисунків – 6, літературних джерел – 11.

У проекті розроблений технологічний процес гальванічного нанесення мідного покриття на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу з використанням сірчанокислого електроліту з добавками типу Grundeinebner Cupracid BL-СТ та Glanzzusatz Cupracid BL. Цей електроліт характеризується високою розсіювальною здатністю, рівномірним розподілом міді по поверхні плати незалежно від її розмірів та рисунка провідників, осадженням пластичного, досить міцного шару з низькими внутрішніми напруженнями. Для нанесення електролітичного покриття вибрана і розрахована гальванічна шестипозиційна ванна із складу спеціалізованої гальванічної автоматичної лінії “Діна плюс 130” з продуктивністю 160 000 плат/рік.

В проекті передбачені заходи щодо техніки безпеки, автоматизації параметрів процесу, запропонований спосіб очистки стічних вод реагентним методом з наступним доочищеннем гальванокоагуляцією, розраховані основні техніко-економічні показники.

Ключові слова: мідення, густина струму, гальванічна ванна, джерело струму, друкована плата, сірчанокислий електроліт, струмопровідний рисунок.

Із	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДП ХЕ1103.1450.000 ПЗ		
Розроб.	Дорош К.Г.				Лит.	Лист	Листов
Перев.	Васильєв Г.С.						
H.							
Утв.	Лінючева						
Розробка технологічного процесу осадження міді на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу					НТУУ "КПІ" ХТФ, гр. ХЕ-11		